

Features (特征)

- 封装
- 宽的发光角度
- (适用于所有的SMT组装和焊接工艺)
- (适用于载带及卷轴)
- (防潮等级 Level 4)
- 包装每卷4000PCS
- RoHS 认证)

Description (描述)

白光LED由蓝光芯片与荧光粉激发而成



注意：操作时应注意静电敏感

释放设备装置

Applications (应用)

- (光学指示)
- (室内显示)
- (汽车照明)
- (LCD背光、转换器，开关和标志，显示器等)
- (用于日光灯管)
- (一般应用)

Package Dimensions (封装尺寸)

Recommended Soldering Pattern (建议焊盘尺寸图)

(备注)

(所有标注尺寸单位为毫米)

(除特别标注外，所有尺寸允许公差±0.15mm)



Selection ("i e (选择指南)

型号	芯片材料	胶体类型

) ass Pro "ction list (批量生产目录)

型号 () () () () ()

HL-A-2835H421W-S1-08-HR3

Absolute Maximum Ratings at $T_a = 25^\circ\text{C}$ 绝对最大额定值

(参数)	(符号)	(值)	(单位)
(功耗)			
(正向电流)			
(峰值正向电流)			
(反向电压)			
(静电)			
(操作温度)			$^\circ\text{C}$
(保存温度)			$^\circ\text{C}$
结温			$^\circ\text{C}$

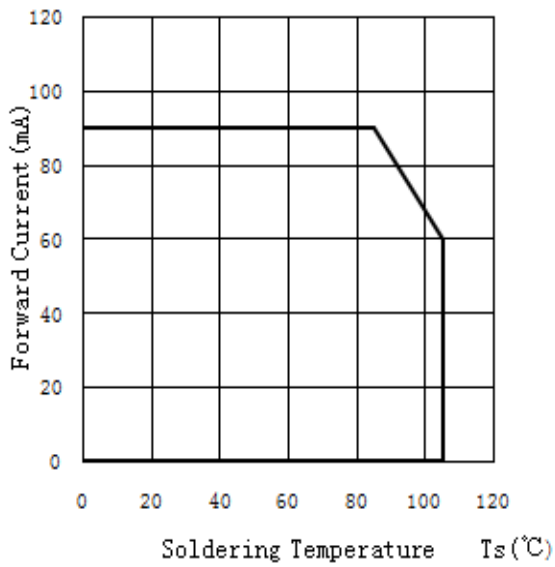
(备注)

(脉宽0.1ms, 周期1/10)

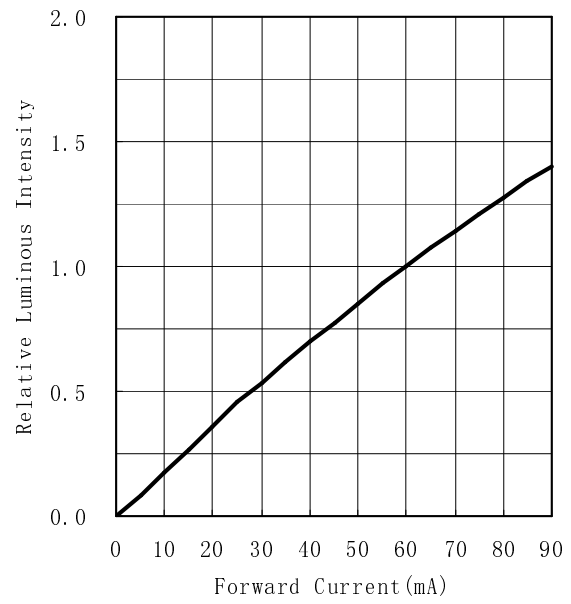
HL-A-2835H421W-S1-08-HR3

#1ypical optical c, aracteristics c"r2es 典型光学特性曲线

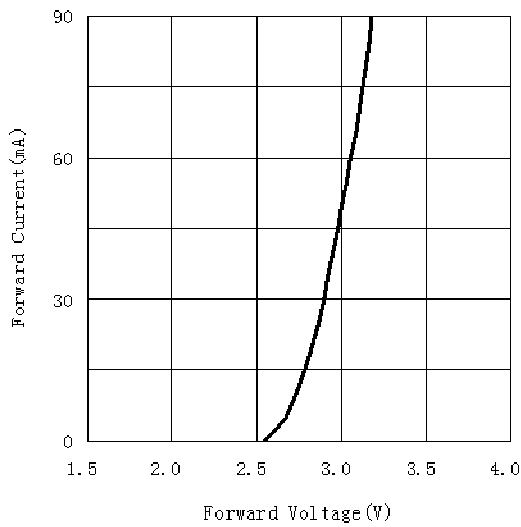
焊 温度与正向电流特性曲线



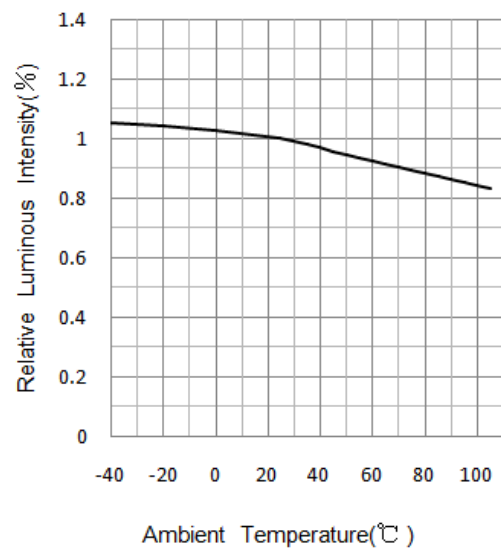
正向电流与相对光强特性曲线



正向电压与正向电流特性曲线

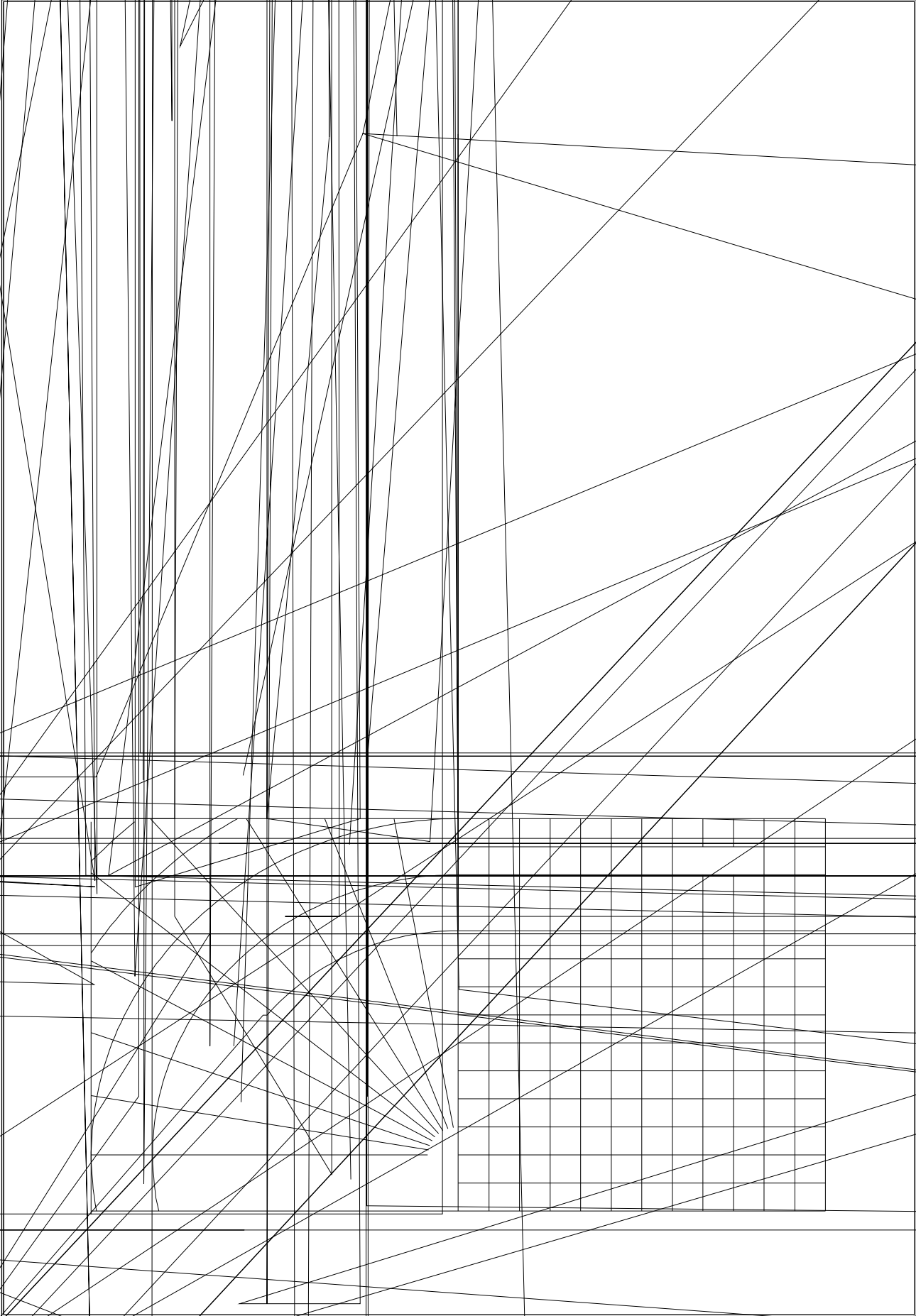


环境温度与相对光强特性曲线





HONGLITRONIC
鸿利光电





HONGLITRONIC
鸿利光电

HL-A-2835H421W-S1-08-HR3

HL-A-2835H421W-S1-08-HR3

3in Range 04 + ,romaticit1 +oor inate Bin区分类及色坐标范围

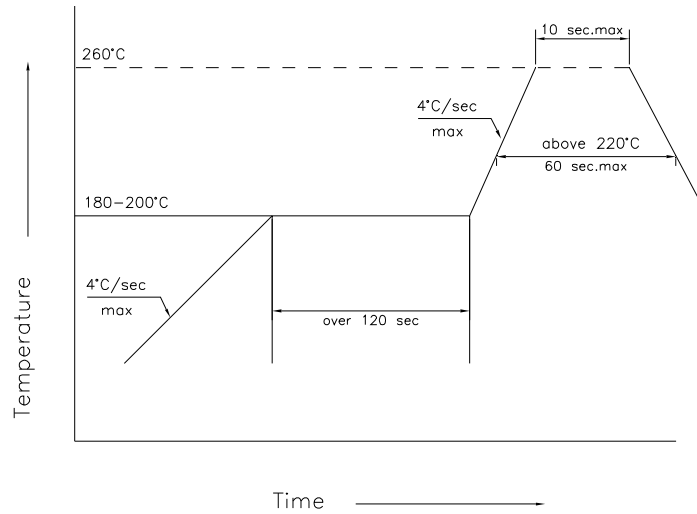
色温	代码	代码	色温
	0.4354	0.4142	0.4316
	0.4430	0.4165	0.4390
	0.4390	0.4082	0.4350
	0.4316	0.4059	0.4279
	0.4279	0.3975	0.4430
	0.4350	0.3998	0.4505
	0.4310	0.3915	0.4463
	0.4241	0.3892	0.4390
	0.4390	0.4082	0.4350
	0.4463	0.4106	0.4420
	0.4420	0.4022	0.4378
	0.4350	0.3998	0.4310
	0.4505	0.4189	0.4463
	0.4581	0.4212	0.4536
	0.4536	0.4129	0.4492
	0.4463	0.4106	0.4420
	0.4420	0.4022	
	0.4492	0.4045	
	0.4447	0.3962	
	0.4378	0.3939	



项目	参考标准	测试条件	时间	数量	接收/拒收
----	------	------	----	----	-------

HL-A-2835H421W-S1-08-HR3

S) # Re4lo5 Sol ering &nstr" ctions S) #回流焊说明



，回流焊不可以做两次以上

当焊接时，不要在材料受热时用力压胶体表面

Sol ering iron 烙铁焊接

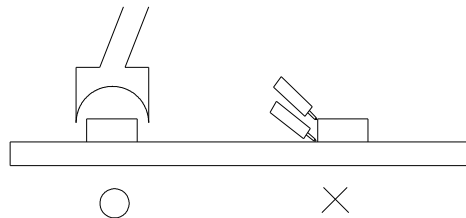
°C

当手工焊接时，烙铁的温度必须小于300°C，时间不可超 3秒

手工焊接只可焊接一次

Repairing 修补

LED回流焊后不应该修复，当修复是不可避免时，必须 用双头烙铁 (如下图)，但必须先确认 这种方式会不会损坏LED本身的特性。

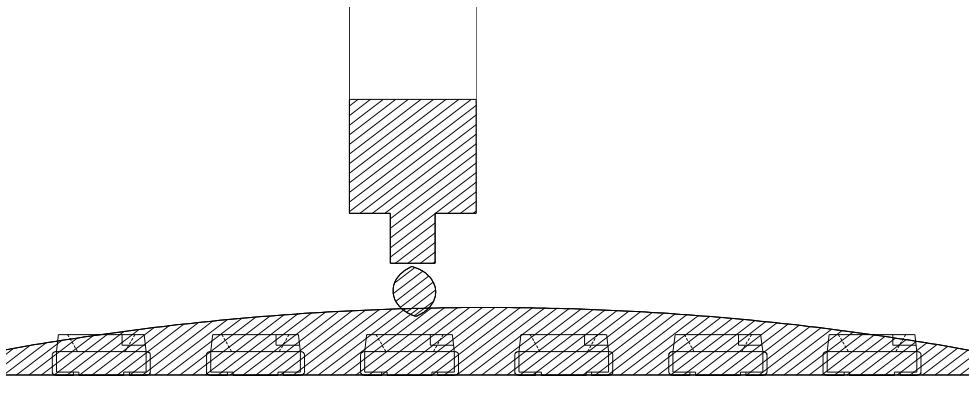


+a"tions 注意事项

LED封 为硅胶，故LED胶体表面较软，用力按压胶体表面会影响LED可靠性，因 应有预防措施避免在封 的零件上的强大压力，当 用吸嘴时，胶体表面的压力应是恰当的。

LED工作环境及与LED适配的材料中硫元素及化合物成份不可超 100PPM

当我们需要 用外封胶涂抹LED产品时，应确保外封胶与LED封 胶水相匹配，因为大多数LED的封 胶水为硅胶，它有较强的氧化性和较强的吸湿性，必须防止外封材质进入LED内部以 成LED的损伤，单一的溴元素含量要求小于900PPM，单一氯元素含量要求小于900PPM，在涂抹LED产品时要求外封胶溴元素与氯元素总含量必须小于1500PPM



其它注意事项请参照我们的LED 用手册

